December 22, 2009

?BEGIN 351

File 351: Derwent WPI 1963-2009/UD=200981 (c) 2009 Thomson Reuters

Set Items Description

?S. PN=JP 62143382

1 PN=JP 62143382 S4

?T 4/5

4/5/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2009 Thomson Reuters. All rts. reserv.

0004263354

WPI ACC NO: 1987-217368/ 198731

Mfg. sheath heater with moisture resist for home use appts. - by melt sealing terminal of metallic pipe and curing epoxy resin mould component

filled in the pipe NoAbstract Dwg 1/2

Patent Assignee: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD (MATU)

Patent Family (2 patents, 1 countries)

Patent

Application

Number Kind Date Number Kind Date Update JP 62143382 Α 19870626 JP 1985283378 A 19851216 198731 19900822 JP 1985283378 A 19851216 199037 JP 1990037072 В

Priority Applications (no., kind, date): JP 1985283378 A 19851216

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

JP 62143382 Α JΑ

Title Terms/Index Terms/Additional Words: MANUFACTURE; SHEATH; HEATER; MOIST; RESIST; HOME; APPARATUS; MELT; SEAL; TERMINAL; METALLIC; PIPE; CURE; EPOXY; RESIN; MOULD; COMPONENT; FILLED; NOABSTRACT

Class Codes

International Classification (+ Attributes)

IPC + Level Value Position Status Version

H05B-0003/04 A I F R 20060101 H05B-0003/48 A I L R 20060101 H05B-0003/02 C I F R 20060101

H05B-0003/42 C I L R 20060101

File Segment: CPI; EPI

DWPI Class: A85; L03; X25; X27

Manual Codes (EPI/S-X): X25-B01D; X27-X

Manual Codes (CPI/A-M): A05-A01E2; A11-C02; A12-E10; L03-H04A

MANUFACTURE OF SHEATHED HEATER

Publication number: JP62143382 (A)

Publication date: 1987-06-26 Inventor(s):

KAWANISHI HIDESATO; KAWADA AKIRA MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Applicant(s): Classification:

- international:

H05B3/04; H05B3/48; H05B3/02; H05B3/42; (IPC1-7): H05B3/04; H05B3/48

Also published as:

■ JP1610969 (C)

- European:

Application number: JP19850283378 19851216 Priority number(s): JP19850283378 19851216

Abstract not available for JP 62143382 (A)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

① 特許出願公開

昭62 - 143382 ② 公開特許公報(A)

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)6月26日

3/04 3/48 H 05 B

7719-3K 7719-3K

発明の数 1 (全3頁) 審査請求 未請求

シーズヒータの製造方法 図発明の名称

> 願 昭60-283378 ②特

願 昭60(1985)12月16日 23出

Ш 西 ⑫発 明 者

英 賢 彭 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

Œ ⑫発 明 者 泂 松下電器産業株式会社 ⑪出 願 人

門真市大字門真1006番地

敏 男 弁理士 中尾 20代 理 人

外1名

1、発明の名称

シーズヒータの製造方法

2、特許請求の範囲

あらかじめ硬化剤を添加し、かつ顆粒状に成型 した未硬化のエポキシ樹脂成型体を、金属パイプ の端末部に充塡し、所定の条件下で熱処理し、前 記ェポキシ樹脂成型体を溶融,硬化させることに より金属パイプの端末部を封止することを特徴と するシーズヒータの製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、一般家庭電化製品の加熱源として広 く使用されるシーズヒータに関し、特に多湿雰囲 気中での電気絶縁特性に優れたシーズヒータの製 造方法に関するものである。

従来の技術

従来より、オーブン、電子レンジ、炊飯器、ホ ットプレートなどの一般家庭電化製品の加熱源と してシーズヒータが広く使用されている。

このシーズヒータは、一般には、両端に電気取 り出し端子を備えたコイル状の電熱縁を金属バイ プの中央部に挿入し、かつこの金属パイプに電融 マグネシア粉末からなる電気絶縁粉末を充塡し、 そして圧延減径後、固溶化熱処理し、所定の形状 に曲げ加工される。

との後、電融マグネシア粉末の除湿を行ない、 **最後に、金属パイプの端末部を封止することによ** り、製造される。

上記封止の方法としては、

- (1) 低融点ガラスによる方法
- (2) エポキシ樹脂による方法
- (3) シリコン樹脂による方法

の大きく分けて3つの方法がある。

しかしながら、(1)の方法では、気密性に優れて いるものの封止後の機械的強度における信頼性の 問題や多大な設備費等の問題があり、また(3)の方 法では、作業性は比較的簡単であるものの透湿性 があり、完全な封止は期待できない。

このため、特に耐熱性を必要としない中、低温

用タイプのシーズヒータには、(2)のエポキシ樹脂 による方法が主に用いられている。

この方法は、あらかじめ硬化剤を添加したエポキン樹脂を、金属パイプの端末部に注入し、この 後、所定の条件で熱処理し、エポキン樹脂を硬化 させることにより行なわれる。

しかしながら、この方法においても、あらかじめ硬化剤とエポキン樹脂の2液を配合して混合する作薬が必要であり、さらに、この混合後、比較的短時間の間に使い切ることが必要であり、したがってポットライフが短かいなどの問題があり、作業性が簡単で、かつ比較的ポットライフの長いエポキン樹脂による對止方法が望まれていた。

このため、本発明者らは、あらかじめエボキシ 樹脂に適量の硬化剤を添加した混合物を用い、未 硬化の円筒状のエボキシ樹脂成型体を準備し、こ れを封止作業の際に金属バイブの端末部に挿入し、 熱処理することにより、急速に溶融させて金属バ イブに接着硬化させ、封止を行なりという方法を 提案した。

に充塡し、所定の条件下で熱処理し、前配エポキ シ樹脂成型体を溶融,硬化させることにより金属 バイブの端末部を封止するようにしたものである。

従来より、エポキン樹脂による封止を行なり場合は、エポキン樹脂に硬化剤を添加し、均一に混合した液体を金属パイプの端末部に注入し、約80℃で熱処理し、硬化させていた。

この方法の改善策として、すでに本発明者らが 提案しているあらかじめ硬化剤を添加した未硬化 の円筒状のエポキシ樹脂成型体を用いる方法では、 従来の作業性の悪さを著しく改善することができ たものの、金属パイブと電気取り出し端子との寸 法関係により、多くの形状の成型体を必要とした り、電気取り出し端子にリード線や、リード板を 接続した後の對止作業においては、不都合が生じ るなど問題点があった。

とのため、本発明では、前述した方法で得られる
の型体をある一定形状および大きさに粉砕して
顆粒状にすることにより、すでに提案している未

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、本発明者らがすでに提案した前述の方法では、シーズヒータの金属バイブの内径 や低気取り出し端子の外径が異なる場合、それぞれに合った寸法形状を有する円筒状の成型体を準備する必要があるため、金型費用の大幅な増大が生じる。

また、低気取り出し端子にリード線やリード板を接続した後では、円筒状の成型体を金属パイプ の端末部に挿入することが困難となる等、いろい ろな不都合が生じるという問題があった。

本発明はこのような問題点を解決するもので、 金属バイブの端末部周辺の構造が変化しても容易 に對止工程ができるとともに耐湿特性に優れたシ ーズヒータの製造方法を提供することを目的とす るものである。

問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために本発明は、あらか じめ硬化剤を添加し、かつ顆粒状に成型した未硬 化のエポキン樹脂成型体を、金属パイプの端末部

硬化のエポキシ樹脂成型体による封止方法をさら に改善したものである。

この顆粒状に成型した未硬化のエポキシ樹脂成型体を用いる本発明の方法では、金属パイプや電気取り出し端子の寸法や、形状が変わっても、特に問題はなく、したがって従来のようにその寸法や形状に合った成型体を準備する必要がなくなる。

また、あらかじめ電気取り出し端子にリード板 やリード線がスポット密接等で接続されても、顆 粒状であるため容易に金属パイプの端末部に充塡 して封止を行なりことができる。

とのように、金属パイプの端末部周辺の構造が 変化しても容易に封止工程を行なりことができる。

また、本発明で得られるシーズヒータは、従来 のエポキシ樹脂の對止方法で得られるシーズヒー タの場合と同様の特性が得られ、優れた耐湿特性 を示す。

さらに、本発明で準備される顆粒状に成型した 未硬化のエポキシ樹脂成型体は、硬化剤の配合条 件により、5℃程度の冷温では、約3カ月程度未

特開昭62-143382(3)

硬化のままで保管することができ、したがって従来、毎日配合していた作業を完全になくすることができるため、作業能率は著しく高まり、またその作業も顆粒状の成型体を金銭パイプの端末部に充填するだけで済み、したがって従来の液体と異なり、作業者の手や作業服の汚れ、あるいは金銭パイプ周辺のエポキシ樹脂の付着による外観品質の低下などを防止することも可能となる。

以上の理由により、金属パイプの端末部周辺の 構造が変化しても容易に封止工程を行なうことが できるとともに、耐湿特性に優れたシーズヒータ の製造方法が可能となるものである。

実 施 例

以下、本発明の一実施例を第1図および第2図 にもとづいて説明する。

まず、両端に電気取り出し端子1を備えたコイル状のニクロム線からなる電熱線2を準備し、この電熱線2を極低炭素鋼からなる金属パイプ3の中央に挿入し、続いて電融マグネシア粉末からなる電気絶繰粉末4を充塡し、圧延減径した。この

のである。

発明の効果

以上の説明から明らかなように本発明によれば、あらかじめ硬化剤を添加し、かつ顆粒状に成型した未硬化のエポキン樹脂成型体を、金属パイプの端末部に充填し、所定の条件下で勢処理し、前記エポキン樹脂成型体を溶融、硬化させるととにより金属パイプの端末部を對止するようにしているため、金属パイプの端末部周辺の構造が変化しても容易に對止工程を行なうことができるとともに、耐湿特性に優れたシーズヒータを得ることができるものである。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すシーズヒータの断面図、第2図は同シーズヒータにおける封止 時の金属パイプ端末部の断面図である。

3……金属パイプ、 6 ……エポキシ樹脂成型体。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 後、電気取り出し端子1 に、第2図に示すように リード板5をスポット溶接し、続いて、顆粒状に 成型した未硬化のエポキシ樹脂成型体6を金属パ イブ3の端末部に充填した。

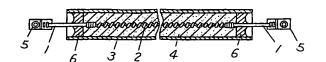
この後、160℃で30分間熱処理することにより、エポキン樹脂成型体8を溶融、硬化させて 對止を完了し、第1図に示す本発明のシーズヒー タを10本完成した。

上記方法により完成した本発明のシーズヒータの評価を行なうために、40cで相対温度が95%の多湿雰囲気中に1カ月間放置し、この後、電気絶縁特性を測定したところ、いずれも2000Mの以上の高い値を示した。

このように、本発明のシーズヒータの製造方法 によれば、金属パイプ3の端末部周辺の構造が変 化しても容易に封止工程を行なうことができ、し たがって、これにより得られたシーズヒータは優 れた耐湿特性を示した。

なお、本発明はシーズヒータに限定されるもの 多ではなく、カートリッジヒータにも適用できるも

第 1 🖄



a 2 🖾

